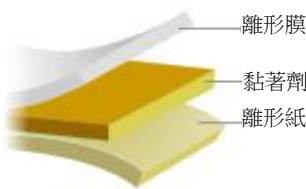


FPC D3430系列熱固膠帶

特點

- 吸濕後也具有絕佳的耐Reflow高溫製程的特性。
- 可於FR4補強板, PI補強板, AL補強板, SUS補強板呈現極佳的黏著強度。
- 可以儲存於室溫環境中, 不需要冷藏。
- 具初期微黏性，易於定位。

結構



產品名稱	D3430	D3431	D3432
主要成份	壓克力/環氧樹脂	壓克力/環氧樹脂	壓克力/環氧樹脂
基材	無基材	無基材	無基材
顏色	淡黃色	淡黃色	淡黃色
黏著劑厚度 (μ m)	約35	約22	約13
離形膜厚度 (μ m)	約38	約38	約38
離形紙厚度 (μ m)	約115	約115	約115
接著強度 (N/10mm) ※	25	22	15
標準尺寸 (寬度及長度)	500mm x 100M	500mm x 100M	500mm x 100M

※90°剝離強度 (被貼物：PI)

<建議壓著條件>

- 真空快壓+熟化
壓合溫度：180~190℃
壓合時間：120秒
真空時間：10~30秒
壓力：15~20KG
熟化條件：160℃、120分鐘

- 傳壓機
壓合溫度：160℃
壓合時間：60分鐘
壓力：30KG

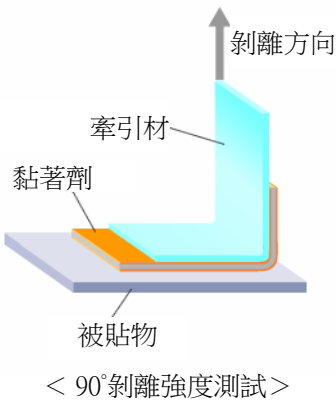
適合用途

- 適用於需經Reflow製程之FPC其補強板(PI, FR4, AL, SUS)固定。



1.對各被貼物之接著強度（90°剝離）

<測試件條件>
 被貼物：Glass Epoxy/Polyimide/Aluminum/Stainless stell
 膠帶寬度：10mm
 壓合條件：建議壓著條件
 量測環境：23℃±5℃，60%±20%RH
 剝離速度：50mm/min
 牽引材：CCL（含銅箔）
 〔量測前先在室溫下放置1hr〕



<結果> (N/10mm)

		D3430	D3431	D3432
真空快壓+熟化	Polyimide	23	18	13
	Glass Epoxy	16	14	13
	Stainless stell	23	19	15
	Aluminum	14	10	7
傳壓機壓合	Polyimide	25	22	15
	Glass Epoxy	16	14	13
	Stainless stell	25	20	16
	Aluminum	20	14	10



2.耐Reflow特性

<樣品製作條件>

被貼物：Polyimide film/D3430 or D3431 or D3432 /CCL

壓合條件：建議壓著條件

Reflow條件：最高至260℃ (請參照迴焊曲線圖)

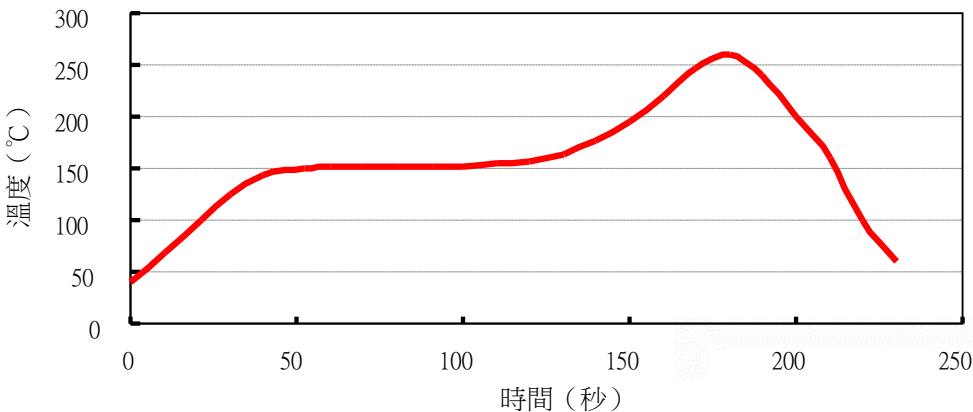
量測環境：23℃±5℃, 60%±20%RH

<實驗結果> *Reflow後進行外觀確認

壓合條件	Reflow前處理	條件	D3430	D3431	D3432
真空快壓+熟化	烘乾	1/100/-	無異狀	無異狀	無異狀
	吸濕	96/40/90	無異狀	無異狀	無異狀
傳壓機壓合	烘乾	1/100/-	無異狀	無異狀	無異狀
	吸濕	96/40/90	無異狀	無異狀	無異狀

※處理時間（H）／溫度（℃）／溼度（%）

<迴焊曲線圖>



附註

- D3430系列的溢膠量，會隨著補強板之厚度、尺寸及形狀而有不同，使用前請先進行確認。特別是在有開孔的補強板上使用時必須特別注意。



特性資料附註：本型錄所述之產品特性資料，係根據本公司之評估結果而制訂，但不保證這些產品特性將符合使用環境之所需。因此，使用前應根據設備及底層所提供之評估資料而檢視相關之用途情況。

Dexerials Corporation

URL : <http://www.dexerials.jp/en/>

總公司： Gate City Osaki, East Tower 8th floor,1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 141-0032(日本東京)

業務及行銷部門／電話： +81-3-5435-3946